

Transfer Molding System

Model YPM1180



All-in-one transfer molding system for high quality molding

高品質成形可能な オールインワントランスファモールド装置

製品情報



日本語

- 100x300mmリードフレーム対応
- 当社独自の高剛性プレス構造(ホールドフレーム®)を採用し、
クランプ面圧の均等化・最適な製品パスライン・コンパクトフットプリントを実現
- リリースフィルム対応(サイドゲート仕様の場合)
- サイドゲート/トップゲート対応
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
モデル			—	YPM1180			
ワークタイプ			—	基板・リードフレーム			
ワークサイズ	長さ		mm	150—300			
	幅		mm	35—100			
樹脂	径		mm	φ 13, 14, 16, 18, 20			
	長さ		mm	14.3—35.0			
マシンタイム			sec	Approximately 20 (25*)			
外形寸法	プレス数		module	1	2	3	4
	スタックマガジン仕様	幅	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
		奥行き	mm	1,600 (1,635*)	1,600 (1,635*)	1,600 (1,635*)	1,600 (1,635*)
		高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
	スリットマガジン仕様	幅	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
		奥行き	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
		高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量	スタックマガジン仕様		ton	6.3 (6.4*)	10.0 (10.2*)	13.7 (14.0*)	17.4 (17.8*)
	スリットマガジン仕様		ton	6.6 (6.7*)	10.3 (10.5*)	14.0 (14.3*)	17.7 (18.1*)
成形取り数			workpiece	2	4	6	8
インプットマガジンスペース			mm	440			
アウトプットマガジン数（スタックマガジン仕様）			pcs	2			
アウトプットマガジンスペース（スリットマガジン仕様）			mm	440			
クランプ出力			kN／(tf)	294.0—1,764.0／30.0—180.0			
トランスファ出力			kN／(tf)	3.92—49.0／0.4—5.0（2圧設定）			
品種切替え方式			—	キット交換式			
搭載可能金型			—	L, XL, 1.5XL, XXL			
リリースフィルム幅			mm	100—300*			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・*の値はリリースフィルム仕様の場合です。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。
ホールドフレームはTOWA株式会社の日本における登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ